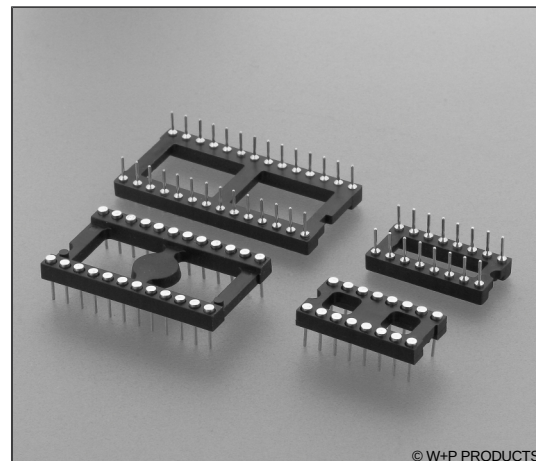


SMT IC-Adapterfassungen RM 2,54mm – Präzisionskontakte schwimmend gelagert

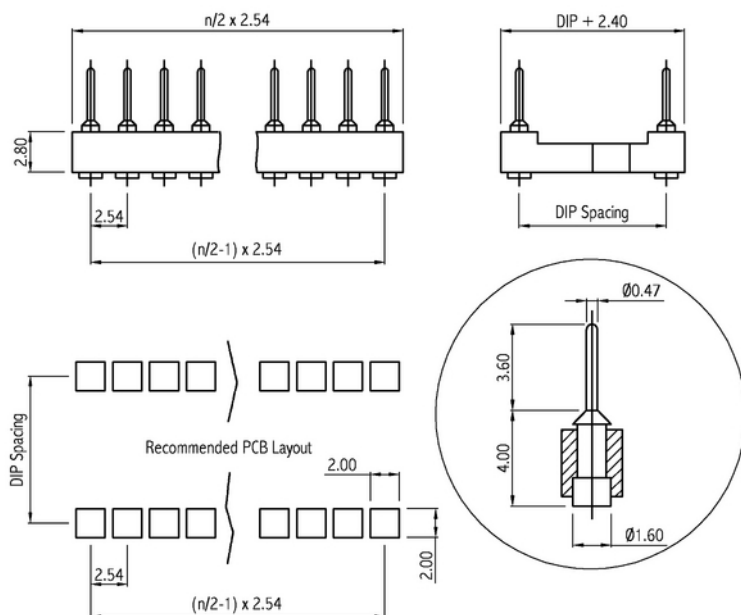
SMT IC-Pin Sockets 2.54mm Pitch – Floating Screw Machined Contacts

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
	Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass
	Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

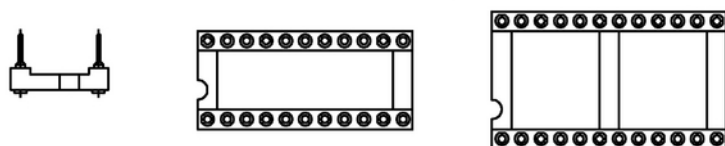


© W+P PRODUCTS

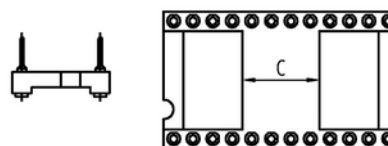


Machine Assembly Type		
n	DIP Spacing	Dimension C
08	3 (7,62)	--
10	2 (5,08)	--
16	3 (7,62)	5,30
24	3 (7,62)	8,30
28	6 (15,24)	10,00
32	6 (15,24)	10,00
40	6 (15,24)	10,00

Manual Assembly



Machine Assembly



Series	Contacts*	DIP Spacing*	Assembly*	Plating*	Package
3232	24	6	1	00	ST
	10 =====>	2 5,08mm	1 Für Handbestückung	00 Au	ST Verpackt in Stangen
	04-10/14-24/28		For manual assembly	10 Au 0,25µm (Option)	Packed in tubes
	=====>	3 7,62mm	2 Für Automatenbestückung	50 Sn	
	22/24/28/32		(s. Tabelle)		
	=====>	4 10,16mm	For machine assembly		
	24/28/32/36/		(s. table)		
	40/42/48 ==>	6 15,24mm			

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

